## 特許協力条約

## 双信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人			
武政 善昭			
	様		
あて名 〒108-0073 日本国東京都港区三田3丁目4番: 岡ビル8F	3号 三田第一長		PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第 40 条の 2) [PCT規則 43 の 2.1]
		発送日 (日.月.年)	14. 6. 2005
出願人又は代理人 の書類記号 PCT413-2005-		今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2005/008588	国際出願日 (日.月.年) 11.05.2005		優先日 (日.月.年)
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. <sup>7</sup> C08J7/C	00 // C08L101:00		·
出願人(氏名又は名称) 柿原工業株式会社			

- 1. この見解書は次の内容を含む。
  - ▽ 第1欄 見解の基礎

厂 第Ⅱ欄 優先権

第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

厂 第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如

「▼ 第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、

それを裏付けるための文献及び説明

第VI欄 ある種の引用文献

第四欄 国際出願の不備

第四欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 際予備審査機関がPCT規 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か ら3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 25, 05, 2005 9 2 6 8 4 J 特許庁審査官(権限のある職員) 名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 森川 聡 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3457 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国際調査機関の見解書		機関の見解書 	国際山願番号 PCI/JP2005/008588	
第1欄 見解の基礎				
1. この見解審は、下	記に示っ	す場合を除くほか、国際出願の言語を基	<b>基礎として作成された。</b>	
この見解書は、それは国際調	、 査のため	語による翻訳文を基礎と Dに提出されたPCT規則12.3及び23.1	として作成した。 (b)にいう翻訳文の言語である。	
2. この国際出願で開 以下に基づき見解			マクレオチド又はアミノ酸配列に関して、	
а. タイプ	Г	配列表		
	۳	配列表に関連するテーブル		
b. フォーマット	Г	書面		
	Г	コンピュータ読み取り可能な形式	•	
c. 提出時期		出願時の国際出願に含まれる		
	Γ	この国際出願と共にコンピュータ読	み取り可能な形式により提出された	
	Γ	出願後に、調査のために、この国際	調査機関に提出された ·	
3. 厂 さらに、配列 た配列が出願 あった。	表又は <b>酢</b> 時に提り	記列表に関連するテーブルを提出した。 出した配列と同一である旨、又は、出版	場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し 類時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が	
4 補足音見:		•		

 第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則 43 の 2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付る文献及び説明

 1. 見解

 新規性 (N)
 請求の範囲 3-6、8、9 有 1、2、7、10 無

 進歩性 (IS)
 請求の範囲 3-6、8、9 有 1、2、7、10 無

 産業上の利用可能性 (IA)
 請求の範囲 1-10

## 2. 文献及び説明

文献1:JP 7-118416 A (出光マテリアル株式会社) 1995.05.05.

請求の範囲 \_\_\_\_\_

請求の範囲1、2、7及び10

請求の範囲1、2、7及び10に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に記載されているから新規性を有しない。

請求の範囲3-6、8及び9

請求の範囲3-6、8及び9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1に対して進歩性を有する。

文献1には、樹脂成形品を表面におけるゴム粒子が略円形状を保つように高温加熱処理すること、樹脂成形品のパーティングライン部分を高温加熱処理すること、樹脂成形品の樹脂表層薄膜剥離が予想される特定の部位を高温加熱処理すること、ABS樹脂製の樹脂成形品について表面温度が $80\sim150$  Cになる加熱温度範囲内で高温加熱処理すること、PC/ABS樹脂製の樹脂成形品について表面温度が $100\sim200$  Cになる加熱温度範囲内で高温加熱処理することが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、樹脂成形品の表層薄膜の浮き上がりによる金属めっき膜が樹脂薄膜と一緒に剥離する現象が抑制されるように樹脂めっきすることができるという有利な効果を発揮する。

## 2. Document and Description

Document 1: JP 7-118416 A (Idemitsu Material Co.) 1995.05.09

Claims 1, 2, 7 and 10

The inventions described in claims 1, 2, 7, and 10 are described in the Document 1 cited in the International Search Report and, accordingly, have no novelty.

Claims 3 to 6, 8 and 9

The inventions described in claims 3 to 6, 8 and 9 have progressiveness to the Document 1 cited in the International Search Report

The Document 1 does not describe a high-temperature heat treatment for maintaining a substantially circular shape of a rubber particle at the surface of the resin molding, a high-temperature heat treatment for the parting line portion of the resin molding, a high-temperature heat treatment for a specific potion of the resin molding which portion is apt to undergo peeling of a thin surface resin film, a high-temperature heat treatment within a range of the heating temperature to render the surface temperature of the resin molding made of ABS resin to 80 to 150°C, and a high-temperature heat treatment within the range of the heating

temperature to render the surface temperature of the resin molding made of PC/ABS resin to 100 to 200°C. On the other hand, the present invention provides an advantageous effect obtained thereby capable of conducting resin plating so as to suppress the phenomenon that the metal plating film is peeled off together with the thin resin film caused by the raising of the surface layer thin film of the resin molding.